



High-Speed



Low Profile



Stacking

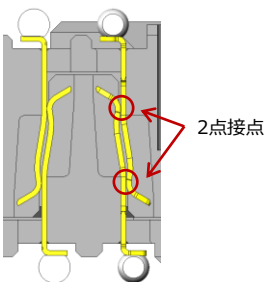


特長

- 1 MOLEX社「Mirror Mezz」正式セカンドソース
- 2 高速伝送対応 (56+Gbps NRZ / 112+Gbps PAM4対応)
- 3 OAM標準接続コネクタ (688芯)
- 4 多芯高密度設計 :
404芯 (101差動ペア) 、688芯 (172差動ペア)
- 5 雌雄同体設計
- 6 スタブレス2点接点構造
- 7 端子先端をハウジングで保護し、かん合時の座屈を防止

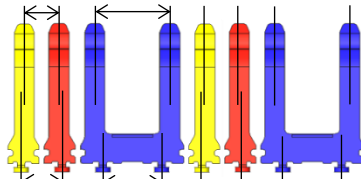
端子構造

スタブレス構造



2点接点

- ・優れたSI性能
- ・2点接点構造で信頼性向上
- ・ワイピング量：最大1.5mm

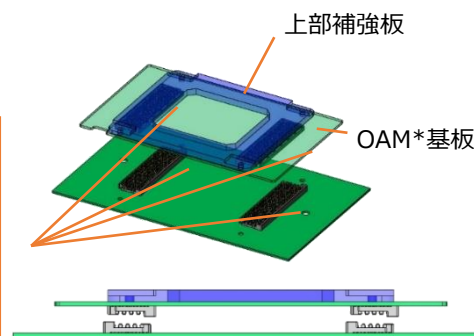
インピーダンスマッチング
(92Ωターゲット)

接触部と実装部のピッチを変え、
インピーダンスを最適化

OAM (OCPアクセラレータモジュール) に採用



IT14:
5mmスタッキング高さ
(2.5mm + 2.5mm)
688芯
172差動ペア



上部補強板

OAM*基板

*OAM = OCP (Open Computer Project) アクセラレータモジュール

仕様

定格電流	1.2A
定格電圧	30V AC/DC
使用温度範囲	-55 ~ +105°C
接触抵抗*	30mΩ 以下
耐電圧	500V DCで1分間
絶縁抵抗	1,000MΩ 以上 (500V DC)
挿抜回数	100回

*導体抵抗を含む

-芯数：404芯 (ボスなし/あり) 、688芯 (ボスあり)

Molex 互換製品番号リスト

HRS 製品番号	HRS No.	Molex 製品番号
IT14-404S-BGA-2.5H	CL0636-6005-0-00	202828-1506
IT14A-404S-BGA-2.5H	CL0636-6006-0-00	202828-0029
IT14-688S-BGA-2.5H	CL0636-6001-0-00	209311-1115

製品番号構成

IT14# - ###S - BGA - 2.5H (##)

1 2 3 4 5

1 シリーズ名	IT14: ポスありタイプ IT14A: ポスなしタイプ
2 極数	404、688
3 形状	BGA構造
4 ハイト	2.5H: 2.5mm (スタッキングハイト: 5.0mm)
5 仕様	(11): 吸着テープ無し (15): 真空包装